



中国移动首发 5G-A 商用部署，三星计划推出 AI 芯片 ——电子行业周报（2024.03.25-2024.03.29）

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

算力芯片：三星计划 2024 年底 2025 年初推出 AI 芯片 Mach-1，算力芯片产业加速发展。三星电子计划 2024 年底 2025 年初推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片 Mach-1。Mach-1 芯片已完成基于 FPGA 的技术验证，正处于 SoC 设计阶段。我们认为，AI 推动算力需求攀升，英伟达算力卡迭代加速，相关产业链有望持续受益。

通感一体化：中国移动在杭州全球首发 5G-A 商用部署，相关产业链或将受益。中国移动在杭州全球首发 5G-A 商用部署，计划于年内扩展至全国超 300 个城市，建成全球最大规模的 5G-A 商用网络。各地已经在水、陆、空全场景开展 5.5G 通感一体关键技术的验证和规模试点。我们认为，5.5G 促进低空经济，通感一体化有望持续受益。

先进封装：美光西安封装和测试工厂扩建项目动工，先进封装产业链有望持续受益。美光科技宣布其位于西安的封装和测试工厂扩建项目正式开工，该厂房将引入包括移动 DRAM、NAND 及 SSD 等。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

HBM：SK 海力士称 2025 年 HBM 供应或将持续紧张，产业链有望持续受益。SK 海力士表示，2024 年 HBM 在整体 DRAM 内存的销售占比将达到两位数，2025 年供应情况依旧紧张。在技术层面，HBM 内存将针对客户需求进行定制，逐渐摆脱通用标准产品的身份。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周（3.25-3.29），A 股申万电子指数下跌 4.43%，整体跑输沪深 300 指数 4.22pct，跑输创业板综指数 1.23pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：光学光电子(-1.09%)、其他电子 II(-1.72%)、元件(-4.17%)、消费电子(-4.49%)、电子化学品 II(-5.63%)、半导体(-5.84%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(0.63%)、费城半导体(-0.06%)、台湾电子(-0.09%)、纳斯达克(-0.3%)、道琼斯美国科技(-1.34%)、申万电子(-4.43%)。

投资建议

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线、助力低空经济的通感一体化产业链、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链。

人工智能：英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

通感一体化：通感一体技术助力低空和水域安全管理，产业链有望持续受益。建议关注国博电子、大富科技、灿勤科技等；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子

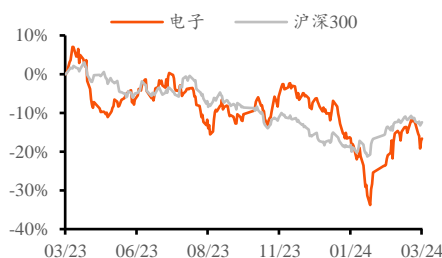
日期： 2024年04月01日

分析师： 陈宇哲

E-mail: chenyzhe@yongxingsc.com

SAC 编号: S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

- 《英伟达发布 B200，GB200NVLink 采用铜缆互连》
——2024 年 03 月 26 日
- 《AI 芯片 WSE-3 发布，三星产 HBM 获 AMD 验证通过》
——2024 年 03 月 18 日
- 《台积电启动扩产，SK 海力士提高 HBM 封装能力》
——2024 年 03 月 12 日

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	6
3. 行业新闻	8
4. 公司动态	11
5. 公司公告	14
6. 风险提示	14

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (3.25-3.29)	5
图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (3.25-3.29)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (3.25-3.29)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (3.25-3.29)	6

表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (3.25-3.29)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (3.25-3.29)	14

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点:

算力芯片：三星计划 2024 年底 2025 年初推出 AI 芯片 Mach-1，算力芯片产业加速发展。根据科创板日报援引 Sedaaily 报道，三星电子 DS（设备解决方案）部门负责人庆桂显宣布，三星电子计划 2024 年底 2025 年初推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片 Mach-1。Mach-1 芯片已完成基于 FPGA 的技术验证，正处于 SoC 设计阶段。该 AI 芯片将于 2024 年底完成制造过程，2025 年初推出基于其的 AI 系统。Mach-1 芯片基于非传统结构，可将片外内存与计算芯片间的瓶颈降低至现有 AI 芯片的 1/8。我们认为，AI 推动算力需求攀升，英伟达算力卡迭代加速，相关产业链有望持续受益。

通感一体化：中国移动在杭州全球首发 5G-A 商用部署，相关产业链或将受益。根据科创板日报报道，中国移动在杭州全球首发 5G-A 商用部署，计划于年内扩展至全国超 300 个城市，建成全球最大规模的 5G-A 商用网络。据央视报道，5.5G 是介于 5G 和 6G 之间的一种过渡阶段的移动通信技术。新通话技术作为华为 5.5G 智能核心网的重要组成部分，已在我国 31 个省份部署，预计可支撑 5000 万用户。我们认为，通感一体化可为低空经济的发展提供有力的技术支撑，产业链有望持续受益。

先进封装：美光西安封装和测试工厂扩建项目动工，先进封装产业链有望持续受益。根据科创板日报援引财联社报道，美光科技宣布其位于西安的封装和测试工厂扩建项目正式开工，该厂房将引入包括移动 DRAM、NAND 及 SSD 等，同时推进收购力成半导体(西安)有限公司相关资产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

HBM：SK 海力士称 2025 年 HBM 供应或将继续紧张，产业链有望持续受益。根据 IT 之家报道，SK 海力士表示，2024 年 HBM 在整体 DRAM 内存的销售占比将达到两位数，2025 年供应情况依旧紧张。在技术层面，HBM 内存将针对客户需求进行定制，逐渐摆脱通用标准产品的身份。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

投资建议:

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线、助力低空经济的通感一体化产业链、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链。

人工智能：英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求

增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

通感一体化：通感一体技术助力低空和水域安全管理，产业链有望持续受益。建议关注国博电子、大富科技、灿勤科技等；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

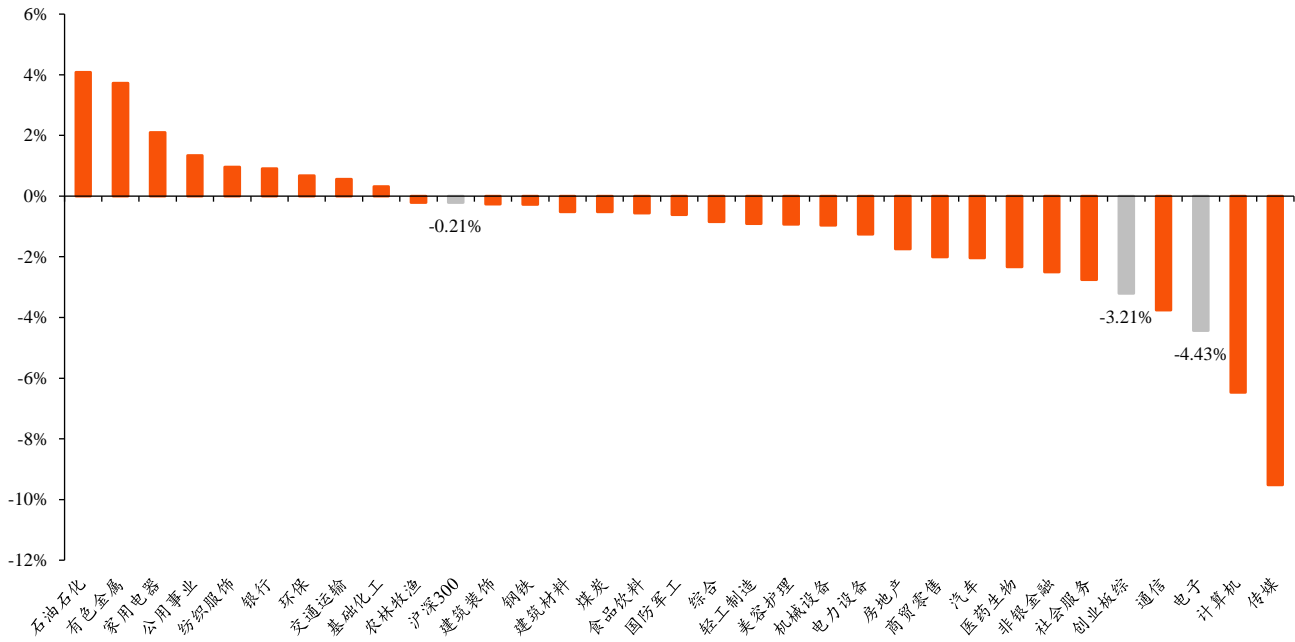
HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周 (3.25-3.29), A 股申万电子指数下跌 4.43%, 板块整体跑输沪深 300 指数 4.22pct, 跑输创业板综指数 1.23pct。在申万 31 个一级子行业中, 电子板块周涨跌幅排名为第 29 位。

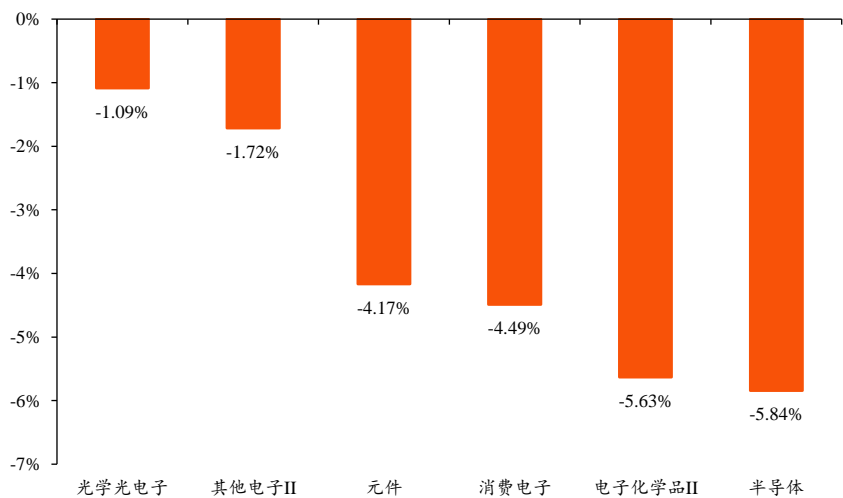
图1:A 股申万一级行业涨跌幅情况 (3.25-3.29)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周 (3.25-3.29) 申万电子二级行业中, 光学光电子板块下跌 1.09%, 表现较好; 半导体板块下跌 5.84%, 表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为: 光学光电子(-1.09%)、其他电子 II(-1.72%)、元件(-4.17%)、消费电子(-4.49%)、电子化学品 II(-5.63%)、半导体(-5.84%)。

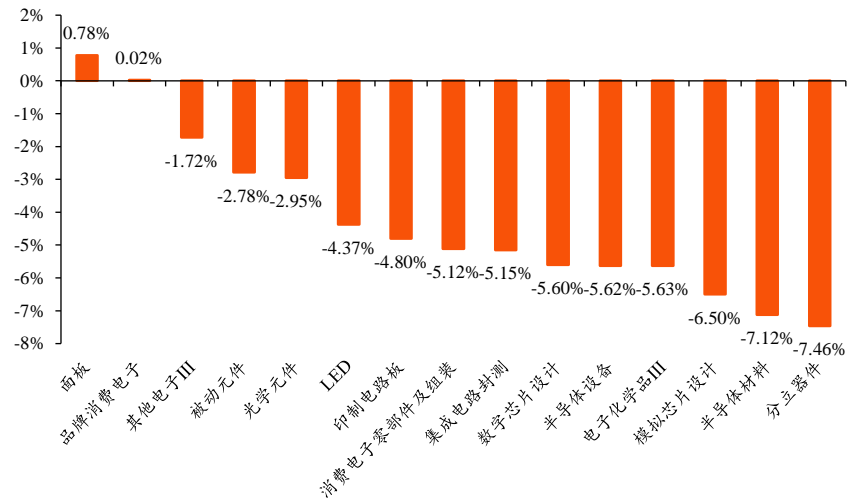
图2:A 股申万二级行业涨跌幅情况 (3.25-3.29)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（3.25-3.29）申万电子三级行业中，面板板块上涨 0.78%，表现较好；分立器件板块下跌 7.46%，表现较差。表现靠前的板块分别为：面板(0.78%)、品牌消费电子(0.02%)、其他电子III(-1.72%)。表现靠后的板块分别为：分立器件(-7.46%)、半导体材料(-7.12%)、模拟芯片设计(-6.5%)。

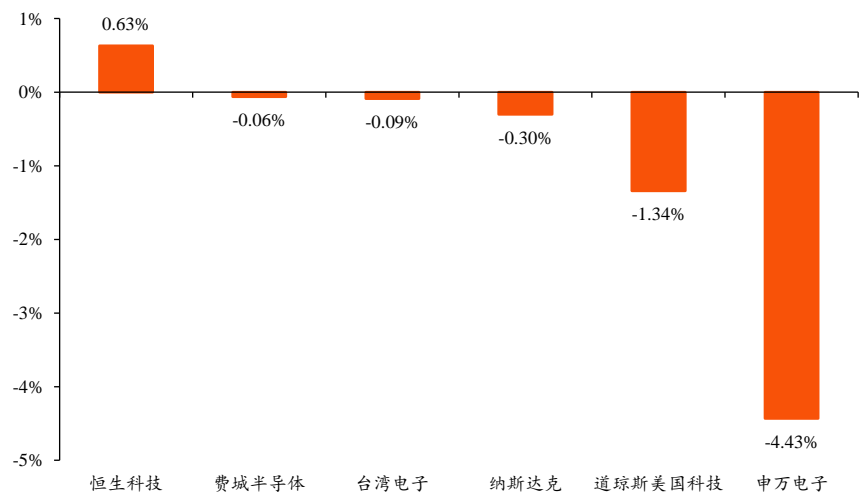
图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（3.25-3.29）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势。本周（3.25-3.29），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(0.63%)、费城半导体(-0.06%)、台湾电子(-0.09%)、纳斯达克(-0.3%)、道琼斯美国科技(-1.34%)、申万电子(-4.43%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（3.25-3.29）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周（3.25-3.29）个股涨跌幅前十位分别为：华体科技（+30.12%）、

沃尔核材 (+22.62%)、科森科技 (+22.22%)、日久光电 (+17.36%)、厦门信达 (+17.11%)、爱克股份 (+16.89%)、硕贝德 (+13.94%)、峰昭科技 (+13.6%)、光弘科技 (+10.05%)、金溢科技 (+9.58%)。个股涨跌幅后十位分别为：长光华芯 (-22.05%)、宏昌电子 (-20.14%)、源杰科技 (-20.08%)、和林微纳 (-18.15%)、*ST 碳元 (-17.84%)、华海诚科 (-17.51%)、新亚电子 (-15.58%)、凯华材料 (-15.56%)、联动科技 (-15.01%)、中晶科技 (-14.94%)。

表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（3.25-3.29）

周涨跌幅前 10 名			周涨跌幅后 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
603679.SH	华体科技	30.12%	688048.SH	长光华芯	-22.05%
002130.SZ	沃尔核材	22.62%	603002.SH	宏昌电子	-20.14%
603626.SH	科森科技	22.22%	688498.SH	源杰科技	-20.08%
003015.SZ	日久光电	17.36%	688661.SH	和林微纳	-18.15%
000701.SZ	厦门信达	17.11%	603133.SH	*ST 碳元	-17.84%
300889.SZ	爱克股份	16.89%	688535.SH	华海诚科	-17.51%
300322.SZ	硕贝德	13.94%	605277.SH	新亚电子	-15.58%
688279.SH	峰昭科技	13.60%	831526.BJ	凯华材料	-15.56%
300735.SZ	光弘科技	10.05%	301369.SZ	联动科技	-15.01%
002869.SZ	金溢科技	9.58%	003026.SZ	中晶科技	-14.94%

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

3. 行业新闻

三星计划 2024 年底 2025 年初推出 AI 芯片 Mach-1

3月21日消息，根据科创板日报援引 Sedaily 报道，三星电子 DS（设备解决方案）部门负责人庆桂显宣布，三星电子计划 2024 年底 2025 年初推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片 Mach-1。Mach-1 芯片已完成基于 FPGA 的技术验证，正处于 SoC 设计阶段。该 AI 芯片将于 2024 年底完成制造过程，2025 年初推出基于其的 AI 系统。Mach-1 芯片基于非传统结构，可将片外内存与计算芯片间的瓶颈降低至现有 AI 芯片的 1/8。此外，其无需现在紧俏而昂贵的 HBM 内存，而是选用了 LPDDR 内存。

资料来源：（科创板日报）

CFM 闪存市场：本周存储现货行情持平为主，上游坚定保利润涨价，现货市场持保守态度

3月26日消息，根据 CFM 闪存市场报道，2024 年一季度步入尾声，由于现货需求端普遍存在一定库存，以及终端需求未见明显好转，备货需求放缓之下，近期存储现货市场普遍面临较大的成交压力。与此同时，原厂涨价态势不减，上游 NAND Wafer 资源保持稳步上扬趋势，据 CFM 闪存市场报价显示，512Gb/1Tb TLC Flash Wafer 价格分别涨至 4.05/7.55 美元，1Tb QLC Flash Wafer 价格涨至 7.00 美元。考虑到存储价格已经经历了全面上涨，且季度末成交动力不足，近期行情整体来到平稳期。上游原厂坚定维持保利润的涨价态度，同时现货市场季度末也需要流水变现，而与 SSD 和内存需求挂钩的 PC 端对涨价承接力不足，good die 资源和中低端资源有所分化，导致市场上出现了些杂音。除大容量嵌入式涨价接受度较高以外，部分订单需结合实际需求而定，短期上游资源的涨幅很难广泛传导至现货成品端，本周存储现货价格基本以持平为主。

资料来源：（CFM 闪存市场）

美光西安封装和测试工厂扩建项目动工

3月27日消息，根据科创板日报援引财联社报道，美光科技宣布其位于西安的封装和测试工厂扩建项目正式开工，该厂房将引入包括移动 DRAM、NAND 及 SSD 等，同时推进收购力成半导体(西安)有限公司相关资产。美光科技全球运营执行副总裁 Manish Bhatia 在接受财联社记者采访时表示，“西安工厂靠近智能手机、PC 和汽车的中国客户，以便更加精准地满足客户的多元化需求，并加速新产品的推广应用，特别是在人工智能、物联网以及低功耗内存技术等前沿领域。”

资料来源：（科创板日报）

三星展示 CMM-B CXL 内存盒模组，HBM3E 12H 内存上半年量产

请务必阅读报告正文后各项声明

3月27日消息，根据IT之家报道，三星电子在近日的存储领域技术会议 Memory Con 2024 上展示了新型 CMM-B CXL 内存盒模组，并表示包括 32Gb 颗粒 128GB DDR5 内存模组在内的新品将于上半年量产。这款名为 CMM-B (CXL Memory Module-Box, CXL 存储模组-盒装) 的设备可容纳 8 个 E3.S 规格的 CMM-D CXL 内存模组，从而实现 2TB 的内存容量，可以 596 纳秒的延迟提供 60GB/s 数据带宽，适合数据分析、内存数据库、AI 等应用。在 Memory Con 2024 会议上，三星还展示了其 12 层堆叠 HBM3E 内存，并表示该产品计划于 2024 年上半年实现量产。

资料来源: (IT之家)

SK 海力士: HBM 2024 年销售额将占整体内存逾一成, 2025 年供应继续紧张

3月28日消息，根据IT之家报道，SK 海力士 CEO 郭鲁正在昨日举行的年度股东大会上表示，2024 年 HBM 在整体 DRAM 内存的销售占比将达到两位数，2025 年供应情况依旧紧张。除了 HBM 的占比提升，这位 CEO 还称由于常规 DRAM 内存价格从去年四季度开始好转，内存业务整体盈利能力将全面改善。此外在技术层面，郭鲁正认为 HBM 内存将针对客户需求进行定制，逐渐摆脱通用标准产品的身份。韩媒 The Elec 称 SK 海力士已收到来自谷歌的定制 HBM 订单。对于中国产能，SK 海力士方面表示已收到了升级许可，可将无锡工厂的 DRAM 工艺更新至 1a nm 制程。

资料来源: (IT之家)

TrendForce 集邦咨询: 预估第二季 NAND Flash 合约价季涨 13~18%，Enterprise SSD 涨幅最高

3月28日消息，根据 TrendForce 集邦咨询表示，除了铠侠 (Kioxia) 和西部数据 (WDC) 自 2024 年第一季度起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季 NAND Flash 采购量较第一季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第二季 NAND Flash 合约价将强势上涨约 13~18%。eMMC 方面，中国智能手机品牌为此波 eMMC 最大需求来源，由于部分供应商已降低供应此类产品，中国模组厂出货大幅提升。买方为了满足生产需求开始扩大采用模组厂方案，助益中国模组厂技术进一步升级及将触角延伸至一线客户，未来中国模组厂将可持续提高对智能手机客户的 eMMC 渗透率。在受到 NAND Flash Wafer 价格剧烈反弹的情况下，预估第二季 eMMC 合约价季增 10~15%。UFS 方面，近期智能手机在印度以及东南亚需求明显成长，支撑第二季 UFS 订单动能，中国智能手机品牌厂也提前在第二季加大订单以建立安全库存水位，需求得以获得支撑。供应方面，各供应商也欲快速实现损益平衡目标，故预估第二季 UFS 合约价将季增 10~15%。Enterprise SSD

方面，受惠于北美及中国云端服务业者（CSP）需求上升，预期 2024 年上半年 Enterprise SSD 采购量将会逐季成长。由于大容量 SSD 订单达成率（Order Fill Rate; OFR）偏低，供应商依旧主导价格走势，故买方被迫接受供应商价格可能性升高。同时，部分买方仍试图在下半年旺季前提提高库存水位，因此，预估第二季 Enterprise SSD 合约价季增 20~25%，涨幅为全线产品最高。Client SSD 方面，由于终端销售仍处淡季，买方备货策略转趋保守，部分 PC OEM 甚至开始下修 2Q24 备货订单。同时，受限于 PC 品牌厂无法在成品上反应 NAND Flash 价格涨幅，也进一步下修第二季订单容量，而此波价格急速反弹更将压抑下半年订单动能成长。预估 PC client SSD 第二季合约价涨幅将小于 Enterprise SSD，季增 10~15%。NAND Flash Wafer 方面，在农历新年假期后，产品销售持续走弱，下游客户已无备货需求。然而，此波涨价导致供应商无法满足来自中国智能手机品牌的订单，从而转单至模组厂。因此，目前中国模组厂为了扩大与智能手机品牌合作，备货需求持续维持高档。由于原厂希望尽快达成获利目标，带动 NAND Flash Wafer 合约价续涨，但受零售市场需求不振影响，涨幅较第一季大幅收敛，预估季增 5~10%。

资料来源：(TrendForce 集邦咨询)

中国移动在杭州全球首发 5G-A 商用部署，计划于年内扩展至全国超 300 个城市

3 月 30 日消息，根据科创板日报报道，中国移动在杭州全球首发 5G-A 商用部署，计划于年内扩展至全国超 300 个城市，建成全球最大规模的 5G-A 商用网络。此前华为有关人士表示：“2024 年很多的手机都会率先支持 5G-A 技术，我们在探索，在通话的过程中，引入实时翻译、数字人等人工智能新技术，甚至未来，一些类似于 AR、VR 这种应用的发展，让大家会有更好的体验。”然而事实上，除了通过手机触达亿万用户，5.5G 还有望在当下爆火的低空经济赛道发挥重要作用。据央视报道，各地已经在水、陆、空全场景开展 5.5G 通感一体关键技术的验证和规模试点。通感一体是 5.5G 乃至 6G 阶段的重要应用场景，可为低空经济的发展提供有力的技术支撑，被视作空管系统升级需要用到的关键通讯技术。

资料来源：(科创板日报)

4. 公司动态

【华微电子】目前公司 IGBT 产品可以应用在机器人制造领域

3月27日消息，华微电子在投资者互动平台表示，公司自上市以来，专注于功率半导体器件的研发、生产和推广，目前产品系列包括 IGBT、MOSFET、SCR、SBD、FRD、BJT 等分立功率半导体器件以及 IPM、PM 等功率模块系列，各产品系列种类齐全。目前公司 IGBT 产品可以应用在机器人制造领域。

资料来源：(投资者互动平台)

【宏微科技】目前公司的产品已应用于 UPS 电源领域

3月27日消息，宏微科技在投资者互动平台表示，数据中心是算力的核心基础设施，数据中心会耗用大量的电力，UPS 电源作为数据中心的重要设备之一，主要负责提供稳定可靠的电力保障，使得在主电源中断时，系统可以继续运行或者至少保持在安全状态下关机，保证数据中心的正常运行。目前，公司的产品已应用于 UPS 电源领域。

资料来源：(投资者互动平台)

【捷捷微电】trench mos 芯片部分产品调价

3月27日消息，捷捷微电在投资者互动平台表示，捷捷微电（南通）科技有限公司于2024年1月的涨价函是给 trench mos 芯片的部分客户发送的，并不是所有客户，也没有对其公开，涨价的范围在函里已经写的很清楚，也是部分产品做了调价，这也属于正常的商业行为。公司的主营产品为各类电力电子器件和芯片，如晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、碳化硅器件等。其中晶闸管在2023年部分产品的价格有小幅下降的情况；防护器件在2023年部分产品有20%-30%的降价，未来价格下浮的空间不大，目前价格比较稳定；MOSFET 部分产品在2023年有5%-10%的降价，目前价格逐步趋于平稳，但竞争依旧非常激烈。

资料来源：(投资者互动平台)

【澜起科技】津逮服务器平台产品线正在逐步恢复

3月25日消息，澜起科技在投资者互动平台表示，采购原材料是产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。从采购原材料到制造产成品，再到交货给客户需要一定的周期。受服务器需求下滑导致的去库存影响，公司2023年度津逮服务器平台产品线同比下降。随着行业去库存已接近尾声，津逮服务器平台产品线正在逐步恢复，但需要一定的过程，提醒投资者注意投资风险。

资料来源：(投资者互动平台)

【国芯科技】已立项开发集成 NPU 功能的 AI MCU 芯片产品计划年内完成设计和流片

3月26日消息，国芯科技在投资者互动平台表示，公司正在进一步加强 AI 关键技术神经网络处理器 NPU 相关技术和芯片的研发和积累，主要包含以下几个方面：（1）2023 年，公司与香港应科院签署了合作备忘录及项目研发支持协议书，双方将建立“香港应科院-苏州国芯新型 AI 芯片联合研究实验室”。公司在接受香港应科院原有神经网络处理器 NPU 技术转移的同时，与香港应科院开展新一代神经网络处理器 NPU 等技术的研发和应用，该技术将用于公司的汽车电子、工业控制应用领域的 AI 芯片开发。（2）结合重大客户的实际紧迫需求，公司已立项开发融合了神经网络处理器 NPU 技术的新一代超高性能云安全芯片产品 CCP917T 的技术规划和研发，预计将于年内推出以满足客户需求，实现对已有自主云安全芯片技术与应用的升级迭代。公司新一代云安全超高速加解密芯片的加密模块 SM2 签名性能可达 100 万次/秒，SM4 加密性能可达 80Gbps，性能提升达到数倍，可满足超高端云安全应用需求，目前相关产品正在积极研发过程中。（3）在端 AI 芯片方面，公司瞄准工业控制和智能家用电器 AI 应用，已立项开发集成 NPU 功能的 AIMCU 芯片产品，并与该 AIMCU 芯片的潜在客户签订合作协议，主要应用于智能电机的能耗优化控制和可预测性维护，产品计划年内完成设计和流片。

资料来源：（投资者互动平台）

【芯海科技】荣耀 MagicBook Pro 16 搭载芯海科技高性能 EC 芯片

3月25日消息，芯海科技在投资者互动平台表示，荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于近日发布，该产品选择搭载了芯海科技高性能 EC 芯片，公司 PC 相关产品目前均已与国内主流笔记本厂家都建立了联系。

资料来源：（投资者互动平台）

【江波龙】公司只具备 HBM 技术部分量产能力，但目前无法生产 HBM

3月27日消息，江波龙在投资者互动平台表示，HBM 技术涉及到公司上游，即存储原厂内存芯片设计技术、晶圆级堆叠技术等不同环节的技术复合型应用，目前全球范围内的 HBM 产品技术应用均以存储晶圆原厂（如 SK hynix，三星等）为主导甚至是存储原厂自行完成封装。公司目前虽然具备晶圆高堆叠封装（即 HBM 技术的一部分）的量产能力，但目前无法生产 HBM。

资料来源：（投资者互动平台）

【希荻微】公司推出的 DC/DC 芯片已进入 Qualcomm 的全球汽车级平台参考设计

3月29日消息，希荻微在投资者互动平台表示，公司推出的DC/DC芯片已进入Qualcomm的全球汽车级平台参考设计，并最终应用于包括奥迪、问界、小鹏、长安等多个品牌汽车的车型中。目前公司汽车类业务总量占比不高，但预计未来存在增量空间。公司会持续加强车规产品的研发，打造丰富的产品矩阵。

资料来源：（投资者互动平台）

【芯联集成】公司8英寸SiC MOS晶圆和芯片研发进展顺利，预计年内送样，2025年量产

3月28日消息，芯联集成在投资者互动平台表示，公司已建设有月产17万片的8英寸硅基晶圆产线、月产5000片的6英寸SiC MOS晶圆产线，月产1万片的12英寸硅基晶圆中试线。目前，公司8英寸SiC MOS晶圆和芯片研发进展顺利，预计年内送样，2025年量产；和新能源战略客户共同开拓SiC MOS在车以外的重大新应用上的开拓，扩大SiC MOS的应用范围。在12英寸硅基晶圆方面，公司BCD技术平台已经过两代技术的更新，第一代产品已经开始小规模量产，第二代55nm解决方案具有非常有竞争力的效率，已获得关键客户定点，未来公司将扩大客户群、加速产品导入。随着公司在SiC MOS产线、12英寸产线、模组产线的快速释放，收入将迅速提升，随着折旧的逐步消化，公司在规模效应、技术领先性以及产品结构等方向的差异化优势将逐渐显现，将快速改善公司的盈利能力。

资料来源：（投资者互动平台）

【凯盛科技】公司UTG有小批量订单出货并已在相关终端手机上应用

3月29日消息，凯盛科技在投资者互动平台表示，公司UTG有小批量订单出货并已在相关终端手机上应用，同时公司也正与多个客户进行全面对接，加快推进UTG及UTG迭代产品进一步市场化。

资料来源：（投资者互动平台）

【美迪凯】公司与客户合作的图像传感器（CIS）晶圆光路系统项目目前已小批量生产

3月26日消息，美迪凯在投资者互动平台表示，公司与客户合作的图像传感器（CIS）晶圆光路系统项目目前已开始小批量生产，每个月在逐步上升。

资料来源：（投资者互动平台）

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告 (3.25-3.29)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/03/25	芯联集成	年度报告	2023 年营业收入约 53.24 亿元, 同比增加 15.59%; 归属于上市公司股东的净利润亏损约 19.58 亿元; 基本每股收益亏损 0.32 元/股。
2024/03/25	协创数据	年度报告	全年实现营业收入 46.58 亿元, 同比增长 47.95%; 净利润 2.87 亿元, 同比增长 119.46%; 基本每股收益 1.23 元/股。
2024/03/25	沪电股份	年度报告	公司主营收入 89.38 亿元, 同比上升 7.23%; 归母净利润 15.13 亿元, 同比上升 11.09%; 扣非净利润 14.08 亿元, 同比上升 11.36%。
2024/03/25	德赛电池	年度报告	公司实现营业收入 202.85 亿元, 同比下降 6.73%; 归属于上市公司股东的净利润 5.62 亿元, 同比下降 35.13%。
2024/03/26	可立克	年度报告	公司营业收入 46.68 亿元, 同比增长 42.86%; 归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元, 同比增长 2.36%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.56 亿元, 同比下降 11.64%; 基本每股收益 0.2339 元/股。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。
2024/03/27	晶方科技	回购股权	拟以 1500 万元-2500 万元回购公司股份, 回购价格不超过 25.93 元/股。
2024/03/27	华海清科	回购股权	按照本次拟回购金额上限人民币 10,000 万元, 回购价格上限 260 元/股进行测算, 回购数量为 38.46 万股, 回购股份比例占公司总股本的 0.24%; 按照本次拟回购金额下限人民币 5,000 万元, 回购价格上限 260 元/股进行测算, 回购数量为 19.23 万股, 回购股份比例占公司总股本的 0.12%。
2024/03/28	有研硅	年度报告	2023 年营业收入约 9.6 亿元, 同比减少 18.29%; 归属于上市公司股东的净利润约 2.54 亿元, 同比减少 27.65%; 基本每股收益 0.2 元/股, 同比减少 37.5%。

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

请务必阅读报告正文后各项声明

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。